(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-77966

(43)公開日 平成9年(1997)3月25日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> |       | 識別記号          | 庁内整理番号 | FΙ         |          |    |         | 技術表示箇所 |
|---------------------------|-------|---------------|--------|------------|----------|----|---------|--------|
| C08L                      | 67/02 | LPF           |        | C08L       | 67/02    |    | LPF     |        |
| C08F                      | 2/44  | MCQ           |        | C08F       | 2/44     |    | MCQ     |        |
|                           |       | MCS           |        |            |          |    | MCS     |        |
|                           | 2/48  | MDH           |        |            | 2/48     |    | MDH     |        |
| C08K                      | 3/08  | КJQ           |        | C08K       | 3/08     |    | КJQ     |        |
|                           |       |               | 審查請求   | 未請求 蘭木     | 表項の数3    | FD | (全 4 頁) | 最終頁に続く |
| (01) III E 18             |       | ALEXTE OFFICE |        | (94) 11155 | 1 000004 |    |         |        |

(21)出願番号

特願平7-259526

(22) 出顧日

平成7年(1995)9月13日

(71)出願人 000004086

日本化薬株式会社

東京都千代田区富士見1丁目11番2号

(72)発明者 樋之口 和彦

埼玉県川口市朝日1-17-2

(72)発明者 森 哲

埼玉県与野市上落合1039

(72)発明者 横島 実

茨城県取手市井野2291

### (54) 【発明の名称】 樹脂組成物及びその硬化物

### (57)【要約】

【課題】希アルカリ水溶液または水での現像ができ、パターン精度が良好で、加熱焼成後の樹脂の残査が少なく、密着性に優れた抵抗体パターン用等の樹脂組成物を提供する。

【解決手段】水溶性のポリエーテル系化合物及び/又はポリエステル系化合物(A)、希釈剤(B)、光重合開始剤(C)、金属粉叉は金属酸化物(D)を含有する事を特徴とする樹脂組成物及びその硬化物。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】水溶性のポリエーテル系化合物及び/又はポリエステル系化合物(A)、希釈剤(B)、光重合開始剤(C)、金属粉及び金属酸化物(D)を含有する事を特徴とする樹脂組成物。

【請求項2】抵抗体パターン,回路パターン又は螢光体パターン用の請求項1の樹脂組成物

【請求項3】請求項1及び2記載の組成物の硬化物。 【発明の詳細な説明】【00017

【発明の属する技術分野】本発明はプラズマディスプレイ等の抵抗体パターン、回路パターン叉は蛍光体パターンの製造工程において好適に用いられ、紫外線による露光及び弱アルカリ水溶液叉は水による現像後に焼成することにより電流を安定的に流す為の良好な抵抗体パターン、優れた導電性を有する回路パターン叉は蛍光体パターンを形成する樹脂組成物及びその硬化物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来より抵抗体ペースト(抵抗体をペースト状にした物)、導体ペースト(銅粉、銀粉等の導電物質をペースト状にした物)叉は蛍光体ペースト(蛍光体をペースト状にしたもの)としては印刷方式、例えばスクリーン印刷等によりパターンを印刷し次いで焼成する事により抵抗体パターン、回路叉は蛍光体パターンを形成するものが知られている。しかし、これらは近年の抵抗体パターン、回路パターン叉は蛍光体パターンの高密度化には対応できない。

### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の欠点を改良し、細密なパターン作成が可能で紫外線で硬化後、弱アルカリ水溶液叉は水で現像し、抵抗体パターン、回路パターン叉は蛍光体パターンを形成し、焼成後、安定的に電流を流させる抵抗体パターン、優れた導電性を有する回路パターン叉は蛍光体パターンを形成する樹脂組成物及びその硬化物を提供する。

### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明は水溶性のポリエーテル系化合物及び/又はポリエステル系化合物(A)、希釈剤(B)光重合開始剤(C)、金属粉及び金属酸化物(D)を含有する事を特徴とする樹脂組成物、特に抵抗体パターン用樹脂組成物、回路パターン用樹脂組成物、螢光体パターン用樹脂組成物及びその硬化

## 物に関する。 【0005】

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。本 発明で用いる水溶性のポリエーテル系化合物及び/又は ポリエステル系化合物 (A) の具体例としては、例えば エチレンオキサイドの開環重合により合成されるポリ (エチレンオキサイド) のポリマー (分子量5~500万)、エチレングリコール、プロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、トリメチロールプロパン、フ

エノール、クレゾール等の水酸基を有する化合物にエチ レンオキサイドを縮合開環重合させて得られるポリエチ レングリコール系ポリマー等のポリエーテル系化合物、 これらポリエーテル系化合物とコハク酸、マレイン酸、 アジピン酸、イタコン酸、フタル酸、イソフタル酸、テ トラヒドロフタル酸等の多塩基酸あるいはその無水物と の反応物あるいは、これらポリエーテル系化合物と ε -カプロラクトンとの反応物であるポリエステル系化合物 等を挙げることができる。具体的商品名としては、第一 工業製薬(株)製、PEG10000、PEG2000 0、パオゲンEP-15、PP-15、明成化学工業 (株) 製、アルコックスR-150、R-1000、E -30、E-240等が挙げられる。又、これらポリエ ーテル系化合物及び/又はポリエステル系化合物(A) は、一種又は二種以上を混合して用いることができる。 【0006】(B)成分の具体例としては、例えば、エ チル(メタ)アクリレート、ブチル(メタ)アクリレー ト、2-ヒドロキシ (メタ) アクリレート、2-ヒドロ キシプロピル (メタ) アクリレート、スチレン、αーア ルキルスチレン、カルビトール (メタ) アクリレート、 (メタ) アクリル酸などのモノ (メタ) アクリレート 類、エチレングリコール (メタ) アクリレート、トリプ ロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、ポリエチ レングリコールジ (メタ) アクリレート、トリメチロー ルプロパントリ(メタ)アクリレート、トリメチロール プロパンポリプロポキシ (メタ) アクリレート、グリセ リンポリプロポキシ (メタ) アクリレート、ペンタエリ スリトールトリ (メタ) アクリレート、ジトリメチロー ルプロパンテトラ(メタ)アクリレート、ペンタエリス リトールポリプロポキシテトラ (メタ) アクリレート等 の多感能(メタ)アクリレート等の反応性希釈剤(B-1)、エチレングリコールモノアルキルエーテル類、エ チレングリコールジアルキルエーテル類、ジエチレング リコールジアルキルエーテル類、エチレングリコールモ ノアルキルエーテルアセテート類、プロピレングリコー ルモノアルキルエーテル類、ジプロピレングリコールジ アルキルエーテル類、プロピレングリコールモノアルキ ルエーテルアセテート類、ジエチレングリコールモノア ルキルエーテルアセテート類、エチレングリコールモノ アリールエーテル類、ジエチレングリコールモノアリー ルエーテル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチル イソブチルケトン等のケトン類、酢酸エチル、酢酸ブチ ル等のエステル類、トルエン、キシレン、ベンジルアル コール等の芳香族炭化水素類、ソルベントナフサ類、プ ロピレンカーボネート等の有機溶剤類(B-2)等を挙

【0007】(C)成分の具体例としては、例えば、 2、4ージエチルチオキサントン、2ークロロチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、2ーメチルー1 - [4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノ

げることができる。

ن

プロパンー1、2ーベンジルー2ージメチルアミノー1ー(4ーモルフォリノフェニルー1ーブタノン、4ーベンゾイル4'ーメチルジフェニルスルフィド、2,4,6ートリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ミヒラーズケトン、ベンジルジメチルケタール、を挙げる事ができる。又、これら光重合開始剤(C)とアミン類などの光重合促進剤との併用することもできる。アミン類などの光重合促進剤としては、例えば、2ージメチルアミノエチルベンゾエート、ジメチルアミノアセトフェノン、pージメチルアミノ安息香酸エチル、pージメチルアミノ安息香酸イソアミルなどを挙げることができる。

【0008】(D)成分の具体例としては好ましくは粒 径が10μm以下の酸化ルテニウム (Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、酸 化イットリウム (Y2 O3)、酸化ユーロピウム (Eu O3 )、酸化サマリウム (Sm2 O3)、酸化セリウム (CeO<sub>2</sub>)、酸化ランタン(La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、酸化プラ セオジム (Pr6 O11)、酸化ネオジム (Nd 2 O3 )、酸化ガドリニウム (Gd2 O3)、酸化テル ビウム (T b4 O7)、酸化ジスプロシウム (D y9 O 3 ) 、酸化ホルミウム(H o 2 O 3 ) 、酸化エルビウム (Er<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、酸化ツリウム(Tm<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)、等の金 属酸化物、銅粉、銀粉、パラジュウム粉、銀とパラジュ ウムの混合粉、表面処理された金粉、ランタン (L a)、セリウム(Ce)、サマリウム(Sm)、プラセ オジム (Pr)、ネオジム (Nd)、プロメチウム (P m)、ユウロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、 テルビウム (Tb)、ジスプロシウム (Dy)、ホルミ ウム (Ho)、ツリウム (Tm)、エルビウム (E r)、ルテニウム(Lu)、イットリウム(Y)スカン ジウム (Sc) 等の金属粉を挙げる事ができる。これら が有する特性により、抵抗体用組成物、回路用組成物、 螢光体用組成物等に応用することができる。

【0009】本発明の樹脂組成物は(A)(B:B-1,B-2)(C)及び(D)成分を溶解、混合、混練することにより調整することができる。本発明の樹脂組成物中、各成分の使用割合は以下のようにすることができる(%は重量%)。(A)成分+(B-1)成分+(C)成分を合計した使用量は組成物に対し $5\sim60\%$ が好ましく特に好ましくは $10\sim40\%$ であり(D)成分は $40\%\sim95\%$ が好ましく特に好ましくは $60\sim90\%$ である。(A)+(B-1)+(C)の合計の量の中に占める各成分の好ましい使用量は以下の通りにな

\*る。すなわち(A)成分の使用量は50%~90%、

(B-1) 成分の使用量は、5~45% (C) 成分の使 用量は、5~30%である。有機溶剤(B-2)の使用 量は、本説明の組成物を使用するために適当な粘度調整 等の目的のために任意の割合で使用することができる。 【0010】本発明の樹脂組成物には、その性能を阻害 しない範囲で、レベリング剤、消泡剤、重合禁止剤、ワ ックス類非反応性ポリマー、ガラスビーズ、あるいはエ ポキシ(メタ)アクリレート、ウレタン(メタ)アクリ レート、ポリエステル (メタ) アクリレート、エポキシ (メタ) アクリレートと多塩基酸無水物の反応物等を使 用する事もできる。本発明の樹脂組成物は、前述のよう に抵抗体用組成物、回路用組成物、螢光体用組成物とし て用いることができ、これらはスクリーン印刷、ロール コート、カーテンフローコート、スプレーコート等の方 法により、ガラス、セラミック基板等の基板上の全面に 印刷塗布される。印刷塗布後、必要に応じて遠赤外線ま たは温風により50~250℃程度にプリベークされ有 機溶剤が除去され、パターニングしたい抵抗体部分、回 路部分叉は蛍光体部分だけが紫外線を通すようにしたネ ガマスクを用いて紫外線による露光が行われる。紫外線 の露光量としては500~5000m J/c m<sup>2</sup>が好ま しい。次に炭酸ナトリウム水溶液、苛性ソーダ水溶液等 の希アルカリ水溶液叉は水の現像液によりスプレーなど の手段で現像され、次いで例えば400℃~1000℃ で焼成され抵抗体、回路叉は蛍光体基板が得られる。

#### 【0011】実施例

以下実施例1~4により本発明を説明する。例中、部と は重量部を表す。

【0012】表1に示す組成にしたがって抵抗体用樹脂組成物を調整した。得られた樹脂組成物を150メッシュのポリエステル製スクリーンを用いてガラス基板上の全面に膜厚35μmでスクリーン印刷し、200℃で30分プリベークした後ネガフィルムを接触させ超高圧水銀灯により3J/cm²を照射し、次いで未露光部を水(液温40℃)を用いてスプレー圧2kg/cm²で2分間現像した。現像後空気中700℃で15分間焼成し、抵抗体パターンを形成した。パターン中の残存樹脂分、現像性、現像後のパターンの状態、ガラス基材への密着性を評価した。

【0013】 【表1】

表 1

|                        | 実施例1 | 実施例2 | 実施例3 | 実施例4 |
|------------------------|------|------|------|------|
| パオゲンEP-15*1            | 10部  | 10部  | 10部  | 5部   |
| ポリエチレングリコール (MW 6,000) |      |      |      | 5 部  |
| KAYARAD PEG400DA*      | : 2  | 5部   | 2.5部 | 5 部  |
| KAYARAD TPGDA*3        | 5部   |      | 2.5部 |      |
| KAYACURE EPA *4        | 2部   | 2部   | 2部   | 2部   |

|     |                                |  | 6   |
|-----|--------------------------------|--|---|
| 2部  | 2部                             | 2部   | 2部  |
| 20部 | 20部                            | 20部  | 20部   |
| 20部 | 20部                            | 20部  | 20部   |
| 40部 | 40部                            | 40部  | 40部   |
| 0.5 | 0.1                            | 0.4  | 0. 2  |
| 0   | 0                              | 0  | 0   |
| 0   | 0                              | 0  | 0   |
| 0   | 0                              | 0  | 0   |
|     | 2 0 部<br>2 0 部<br>4 0 部<br>0.5 | 2 0 部 2 0 部<br>2 0 部 2 0 部<br>4 0 部 4 0 部<br>0 . 5 0 . 1 | 20部 20部 20部   20部 20部 20部   40部 40部 40部   0.5 0.1 0.4   0 0 0   0 0 0 |

### 【0014】注

\*1パオゲンEP15:第一工業製薬株式会社製ポリエ 10 ーテルポリエステルポリマー

\*2KAYARAD PEG400DA:日本化薬 (株) 製、ポリエチレングリコールジアクリレート

- \*3KAYARAD TPGDA:日本化薬(株) 製、 トリプロピレングリコールジアクリレート
- \*4KAYACURE EPA:日本化薬(株)製、光 重合開始剤、pージメチルアミノ安息香酸エチルエステル

\*5 KAYACUREDETX-S:日本化薬 (株) 製、光重合開始剤、2、4ージエチルチオキサントン 【0015】 (残存有機分) 700℃加熱後の重量減少 分を測定。

【0016】 (現像性) 下記の評価基準を使用した。

○・・・・現像時完全に現像できた。

×・・・・現像時わずかに残さがあるもの。

△・・・・現像時、現像されない部分がある。

【0017】 (現像後のパターンの状態)

〇・・・・パターンは正確に維持されている。

×・・・・・パターンの幅が細くなっている。

△・・・・パターン部分の一部または、全部剝がれている。

### 【0018】 (密着性)

○・・・・・100/100で剥がれない物

 $\times \cdot \cdot \cdot \cdot 50/100 \sim 90/100$ 

 $\triangle \cdot \cdot \cdot \cdot 0/100 \sim 50/100$ 

【0019】表1の結果から明らかなように、本発明の 樹脂組成物及びその硬化物は現像性に優れ、現像後のパ ターン精度が良好で、焼成可能で、密着性に優れてい 20 る。

### [0020]

【発明の効果】本発明の樹脂組成物は、パターンを形成したフィルムを通して選択的に紫外線により露光し、未露光部分を現像することによる抵抗体、回路パターン叉は蛍光体パターン形成において、現像性に優れ、現像後のパターン精度が良好で、低温にて焼成可能で密着性に優れた物である。

# フロントページの続き

|                            |      | •      |               |     |        |
|----------------------------|------|--------|---------------|-----|--------|
| (51) Int. Cl. <sup>6</sup> | 識別記号 | 庁内整理番号 | FI            |     | 技術表示箇所 |
| C 0 8 K 3/22               | КJR  |        | C 0 8 K 3/22  | КJR |        |
| 5/00                       | КЈТ  |        | 5/00          | КЈТ |        |
| C 0 8 L 71/02              | LQD  |        | C 0 8 L 71/02 | LQD |        |
|                            | LQE  |        |               | LQE |        |
| C 0 9 D 4/00               | PDQ  |        | C 0 9 D 4/00  | PDQ |        |
| G 0 3 F 7/032              |      |        | G O 3 F 7/032 |     |        |